



第24期 中間（第2四半期）報告書

平成20年4月1日から平成20年9月30日まで

東京エレクトロン デバイス株式会社

証券コード 2760

株主の皆様へ



株主の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社第24期中間報告書（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）として事業の概況等をご報告いたします。

代表取締役社長 砂川 俊昭

当中間期（第2四半期）の経営成績

当中間期におけるわが国経済は、長期化するサブプライムローン問題の影響により、米国金融市場の混乱が世界規模の金融不安へと拡大する中、為替の急激な変動等を含め、景気後退に対する懸念が一層深まる状況下で推移いたしました。

当社グループが参画いたしておりますエレクトロニクス業界では、北京オリンピック開催によるデジタル家電の需要拡大が期待されておりました。しかしながら、景況感の悪化に伴う個人消費の低迷により、一部の製品（低価格ノートPC等）には根強い需要はあるものの、デジタル家電を始めとするエレクトロニクス製品全般について販売数の伸び悩みが見られました。また、企業業績の下振れリスクが払拭されない中、IT投資を含めた設備投資についても縮小傾向が続いております。

このような厳しい事業環境の中、半導体及び電子デバイス事業では、携帯電話向けメモリICの需要が低調でありましたが、PC向けメモリICは堅調に推移いたしました。また、携帯電話基地局向けカスタムICが、引き続き回復基調で推移したこと等により、売上高は423億1千2百万円となりました。

コンピュータシステム関連事業では、景気の失速を背景とした企業業績の悪化懸念に伴い、設備投資等の見直しや、新規投資の抑制傾向が強まっている影響を受け、売上高は101億2千万円となりました。

この結果、当中間期の連結業績につきましては、売上高524億3千2百万円（前年同期比2.5%減）、営業利益15億9千3百万円（前年同期比13.2%減）、経常利益15億8百万円（前年同期比17.3%減）、中間（四半期）純利益7億3千1百万円（前年同期比31.0%減）となりました。

当期活動方針

● 半導体及び電子デバイス事業の強化

顧客に密着した営業展開及び新規顧客・新規商品の開拓を推進し、産業機器分野への販売強化に努めてまいります。

● 海外事業展開の推進

主にアジア地域において、サポート体制と販売体制を強化してまいります。また、付加価値の高い自社商品のグローバルな販売展開を図ってまいります。

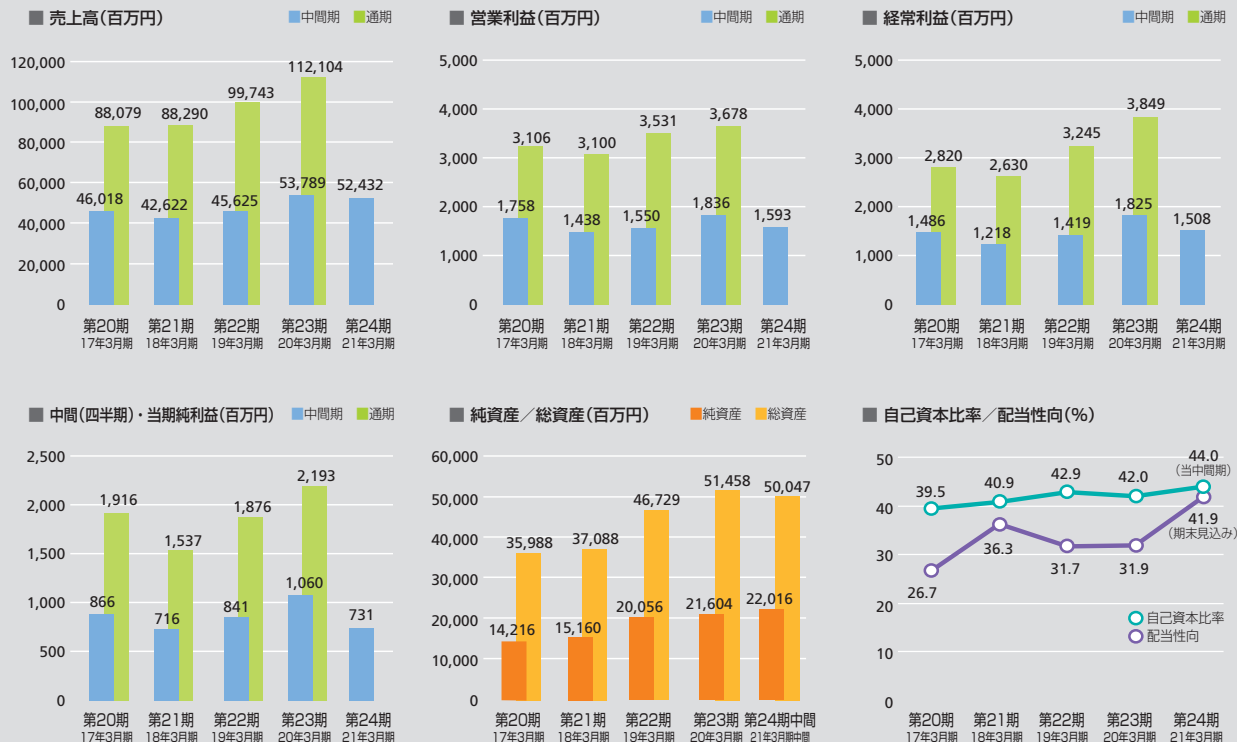
● コンピュータシステム関連事業の強化

成長性のあるコンピュータ・ネットワーク機器の販売戦略推進に努めてまいります。

● 開発ビジネスの強化

自社ブランドである「inrevium（インレビウム）」の商品開発に注力し、産業機器分野向けを中心として一層の販売拡大を図ってまいります。

業績ハイライト



(注) 平成18年3月期より連結決算を開始しており、平成18年3月期以降は連結数値を記載しております。

株主還元について

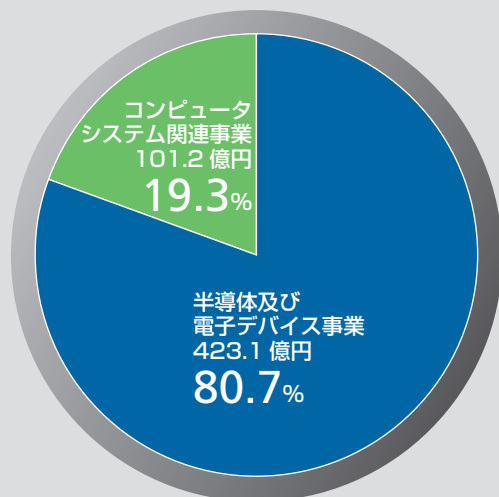
当社は、継続的かつ安定的な配当実施を原則としております。また、成長に応じた利益還元も重視し、業績連動型配当として連結当期純利益に対する配当性向30%を目安とすることを基本方針としております。この方針のもと、中間配当につきましては3,300円とさせていただき、期末配当につきましても3,300円を予定しております。

	平成20年3月期		平成21年3月期	
	中間	期末	中間	期末(見込み)
1株当たり配当金(円)	3,300	3,300	3,300	3,300
配当性向	31.9%		41.9% (見込み)	

事業紹介

当社グループは、半導体製品、電子部品他の仕入・販売及び設計・開発を展開する「半導体及び電子デバイス事業」と、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェアをソリューションとして提供する「コンピュータシステム関連事業」を展開しております。

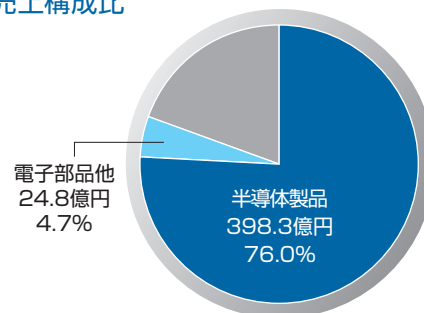
● セグメント別連結売上構成



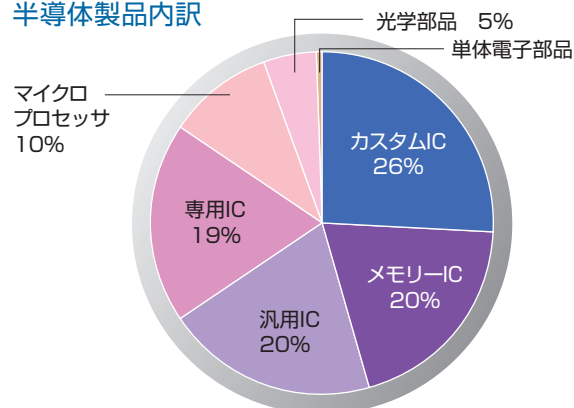
半導体及び電子デバイス事業

半導体及び電子デバイス事業の当中間期の売上構成は以下のとおりです。

売上構成比



半導体製品内訳



- カスタムIC：携帯電話基地局向け回復
- メモリーIC：PC向け堅調も携帯電話向け低調
- 汎用IC：アナログICが各分野で伸長
- 専用IC：プロジェクター、プリンター向け減少

半導体製品



カスタム IC お客様の仕様に応じて作られる固有 IC、ASIC や PLD が代表製品

inrevium

主な商品

- ASIC *1
- PLD *2 (FPGA, CPLD)

主な仕入先 (アルファベット順)

富士通エレクトロニクス(株)、
ザイリンクス社



メモリー IC 記憶専用の IC、書き込みと読み出しが可能な RAM、読み出しのみの ROM など

主な商品

- フラッシュメモリ*3
- DARAM/SRAM
- FRAM

主な仕入先 (アルファベット順)

富士通エレクトロニクス(株)、アイ・ディー・ティー社、
ラムトロンインターナショナル社



汎用 IC 色々な用途に共通して使用される IC、アナログ IC やロジック IC など

主な商品

- アナログ IC
- ロジック IC

主な仕入先 (アルファベット順)

リニアテクノロジー社、オン・セミコンダクター社、
テキサス・インスツルメンツ社



専用 IC 通信や画像処理など、特定用途向けに作られた専用の IC

inrevium

主な商品

- 通信・ネットワーク用
- 画像処理用
- インタフェース用
- セキュリティ用
- 周辺制御用

主な仕入先 (アルファベット順)

キャビウムネットワークス社、コネクサントシステムズ社、
フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス(株)、
インターシル社、ピクセルワークス社、ザーリンク・セミコンダクター社



マイクロプロセッサ コンピュータの中心となる頭脳として、演算・制御機能を持つ IC

主な商品

- マイクロプロセッサ
- マイクロコントローラ
- DSP

主な仕入先 (アルファベット順)

AMD社、フリースケール・セミコンダクタ社、
富士通エレクトロニクス(株)、テキサス・インスツルメンツ社



光学部品 電気を光に変換して使用する電子部品

主な商品

- LED *4
- フォトカプラ*5
- 光ファイバー
- IrDA *6

主な仕入先 (アルファベット順)

アバゴ・テクノロジー社、ユーティナデバイス(株)



単体電子部品 増幅や整流など、電気の基本機能を持つ部品

主な商品

- ダイオード*7
- トランジスタ

主な仕入先 (アルファベット順)

オン・セミコンダクター社

電子部品他

inrevium



主な商品

- CPU ボード
- インタフェースボード
- 評価ボード
- 組込みボード
- パネル PC
- LCD *8
- 電源
- コネクタ
- IC ソケット

主な仕入先 (アルファベット順)

コーセル(株)、ダイアロジック社、(株)デジタル、(株)PFU

※1 [ASIC] 高性能が望めるが、開発期間が長くなるカスタム IC。

※2 [PLD] プログラム可能な論理素子のカスタム IC。ASIC より短期開発が可能。

※3 [フラッシュメモリ] データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。

※4 [LED] 電流を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。

※5 [フォトカプラ] 電気信号を光に変換して伝達する素子。電氣的な絶縁が利点。

※6 [IrDA] 規格団体により制定された赤外線使用の通信機能。モバイル機器などで使用。

※7 [ダイオード] 電流を一方方向のみに流す整流作用を持つ電子部品。

※8 [LCD] 液晶を使用したディスプレイ。ノートPCなどに使用。

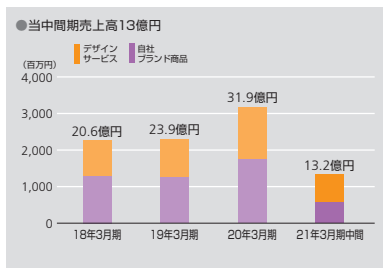
半導体及び電子デバイス事業

開発ビジネス

開発ビジネス（自社ブランドビジネス）は、お客様の要求に基づきカスタムICやボードの設計を行う設計受託業務（デザインサービス）と市場ニーズに沿ったLSIやボード製品の企画開発を行う自社ブランド商品で構成されております。

■ 開発ビジネス売上高推移

inrevium



■ 自社ブランド商品開発例

inrevium

当社取り扱い商品「ザイリンクス社製FPGA」を4つ並列搭載した高速演算処理用評価ボード。

大学、研究機関向け高速演算処理システム開発用として販売。

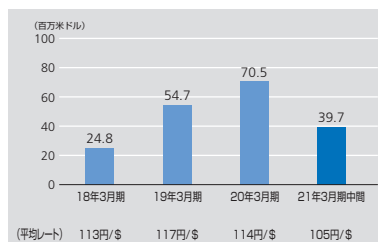


〈主な応用分野〉 宇宙、天体観測、DNA解析など

海外ビジネス

日系企業を主なお客様として、アジア地域に営業拠点を展開しております。平成17年に東京エレクトロンデバイス香港、平成20年に東京エレクトロンデバイスシンガポールを設立し、上海・大連にも拠点を構え、多言語対応、良質な物流対応に注力しております。

■ 海外ビジネス売上高推移



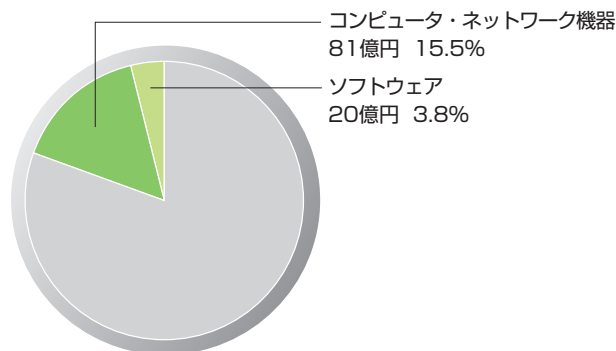
■ 海外営業拠点



コンピュータシステム関連事業

コンピュータシステム関連事業の取扱い商品は、データを効率的に管理するSAN（ストレージ・エリア・ネットワーク）関連機器、ネットワークの構築に必要な企業向けシステム構築機器やインターネット接続機器、マイクロソフト社のソフトウェア等となります。当中間期の売上構成は右図のとおりです。

売上構成比



コンピュータ・ネットワーク機器



ストレージ関連 SAN（ストレージ・エリア・ネットワーク）スイッチ、SAN 接続機器、ストレージセキュリティ機器など

主な商品

- SAN ファブリックスイッチ
- バックアップアプライアンス
- テープライブラリ
- ファイバーチャネルホストバスアダプタ
- クラスタ・ストレージ
- ストレージセキュリティアプライアンス

主な仕入先（アルファベット順）

ブロードコムコミュニケーションズシステムズ社、データドメイン社、エミュレックス社、アイシロン・システムズ社、クアンタム社、ストアワイズ社、シマンテック社



ネットワーク関連 インターネット接続機器（負荷分散、セキュリティ）、企業向けネットワークシステム構築機器など

主な商品

- アプリケーショントラフィックマネージャ
- LAN スイッチ
- ファイアウォール
- VPN アプライアンス
- ハードウェアセキュリティモジュール

主な仕入先（アルファベット順）

エクストリーム・ネットワークス社、F5ネットワークス社、インバーバ社、インフォブックス社、ジュニパーネットワークス社、エンサイファ社、セキュアコンピューティング社

ソフトウェア



主な商品

- OS ● BIOS*
- 開発ツール
- インメモリ・データベース
- 組込みデータベース・エンジン
- ログ長期保存・分析・ツール

主な仕入先（アルファベット順）

インターバルゼロ社、マイクロソフト社、オラクル社、フェニックス・テクノロジーズ社、センセージ社

* [BIOS] キーボードやディスプレイなど基本的なデバイス制御するソフトウェア。

連結財務諸表

中間（第2四半期）連結貸借対照表

資産の部	前中間期	第2四半期末	前 期
	(平成19年9月30日現在)	(平成20年9月30日現在)	(平成20年3月31日現在)
	千円	千円	千円
流動資産	42,747,896	45,487,781	47,005,467
現金及び預金	1,235,923	1,420,885	1,367,624
受取手形及び売掛金	22,016,563	20,774,167	25,633,561
たな卸資産	17,311,450	20,272,674	17,649,887
その他	2,186,019	3,022,057	2,365,852
貸倒引当金	△ 2,059	△ 2,004	△ 11,458
固定資産	3,830,130	4,559,567	4,453,012
有形固定資産	1,083,885	1,193,085	1,012,699
無形固定資産	504,768	719,588	785,538
投資その他の資産	2,241,476	2,646,893	2,654,774
資産合計	46,578,027	50,047,348	51,458,480

■ 資産

総資産は500億4千7百万円となり、前期年度末（平成20年3月31日）に比べ14億1千1百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産が増加した一方、受取手形及び売掛金が減少したことによります。

■ 負債

負債総額は280億3千万円となり、前期年度末（平成20年3月31日）に比べ18億2千2百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金、買掛金が減少したことによります。

負債の部	前中間期	第2四半期末	前 期
	(平成19年9月30日現在)	(平成20年9月30日現在)	(平成20年3月31日現在)
	千円	千円	千円
流動負債	21,701,379	23,496,702	25,584,200
買掛金	12,511,706	13,377,337	13,897,701
短期借入金	755,736	4,747,136	6,069,679
一年以内返済予定長期借入金	3,000,000	-	-
未払法人税等	789,829	695,230	1,043,627
賞与引当金	638,104	684,413	663,307
役員賞与引当金	22,275	17,375	44,550
その他	3,983,727	3,975,210	3,865,334
固定負債	4,073,263	4,534,058	4,269,405
退職給付引当金	3,709,635	4,081,158	3,859,577
役員退職慰労引当金	115,428	121,100	129,928
その他	248,200	331,800	279,900
負債合計	25,774,642	28,030,761	29,853,605
純資産の部			
株主資本	20,797,167	21,957,196	21,579,799
資本金	2,495,750	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	12,656,177	13,816,205	13,438,808
評価・換算差額等	6,216	59,391	25,074
その他有価証券評価差額金	△ 893	△ 4,416	△ 5,420
繰延ヘッジ損益	8,392	93,427	64,622
為替換算調整勘定	△ 1,281	△ 29,619	△ 34,127
純資産合計	20,803,384	22,016,587	21,604,874
負債及び純資産合計	46,578,027	50,047,348	51,458,480

■ 純資産

純資産総額は220億1千6百万円となり、前期年度末（平成20年3月31日）に比べ4億1千1百万円の増加となりました。自己資本比率は、44%となり、前期年度末に比べ、2.0ポイント増加いたしました。

中間（第2四半期）連結損益計算書

科 目	前中間期	第2四半期累計
	(平成19年4月1日から 平成19年9月30日まで)	(平成20年4月1日から 平成20年9月30日まで)
	千円	千円
売上高	53,789,922	52,432,449
売上原価	45,614,918	44,096,057
売上総利益	8,175,004	8,336,391
販売費及び一般管理費	6,338,150	6,742,814
営業利益	1,836,853	1,593,576
営業外収益	120,805	58,945
営業外費用	132,251	143,706
経常利益	1,825,408	1,508,816
特別利益	4,611	4,282
特別損失	5,354	136,184
税金等調整前中間（四半期）純利益	1,824,664	1,376,913
法人税等	764,011	644,992
中間（四半期）純利益	1,060,653	731,920

中間（第2四半期）連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	前中間期	第2四半期累計
	(平成19年4月1日から 平成19年9月30日まで)	(平成20年4月1日から 平成20年9月30日まで)
	千円	千円
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,508,685	2,159,604
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 501,503	△ 499,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 911,172	△ 1,687,902
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 2,754	13,992
現金及び現金同等物の増減額	93,255	△ 13,843
現金及び現金同等物の期首残高	1,142,667	1,367,624
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	67,103
現金及び現金同等物の中間期（四半期）末残高	1,235,923	1,420,885

(注) 連結財務諸表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

当期から四半期開示制度に伴う会計基準の変更により、連結損益計算書ならびに連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、第2四半期連結累計期間の業績について掲載しております。前中間期の数値については、参考数値として掲載させていただいております。

平成21年3月期 通期連結業績予想

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A) 5月12日	115,000	4,305	4,020	2,210	20,849 06
今回発表予想 (B) 10月28日	104,000	3,330	3,100	1,670	15,754 72
増減額 (B-A)	△ 11,000	△ 975	△ 920	△ 540	-
増減率 (%)	△ 9.6	△ 22.6	△ 22.9	△ 24.4	-

米国発の金融不安の深刻化に伴う世界的な経済環境の悪化は当初の予想を上回る状況にあり、当社グループを取り巻くビジネス環境につきましても、極めて不透明感が強い状況となっております。

このような近時の経済状況及び中間期までの動向等を踏まえて業績予想の見直しを行った結果、通期の業績予想につきましては、前回公表（平成20年5月12日）の数値を下回る見込みとなりました。

株式情報 (平成20年9月30日現在)

株式の状況

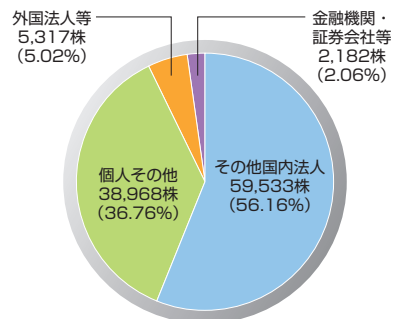
●発行可能株式総数	256,000 株
●発行済株式の総数	106,000 株
●株主数	5,626 名

大株主

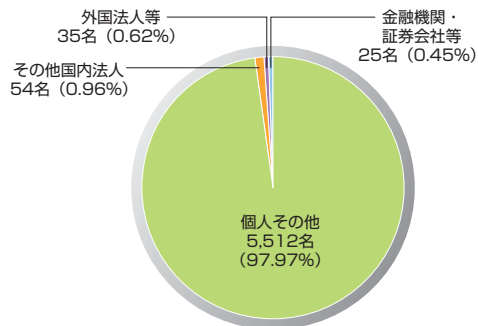
株 主 名	持株数	出資比率
	株	%
東京エレクトロン株式会社	58,753	55.42
東京エレクトロンデバイス社員持株会	3,366	3.17
ユービーエス エージー ロンドン アカウント アイピービー セグリゲイテッド クライアント アカウント	3,333	3.14
ノーザン トラスト カンパニー エイブイ エフシー リ ノーザン トラスト ガンジー ノン トリーティィー クライアント	839	0.79
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	596	0.56

株式分布状況

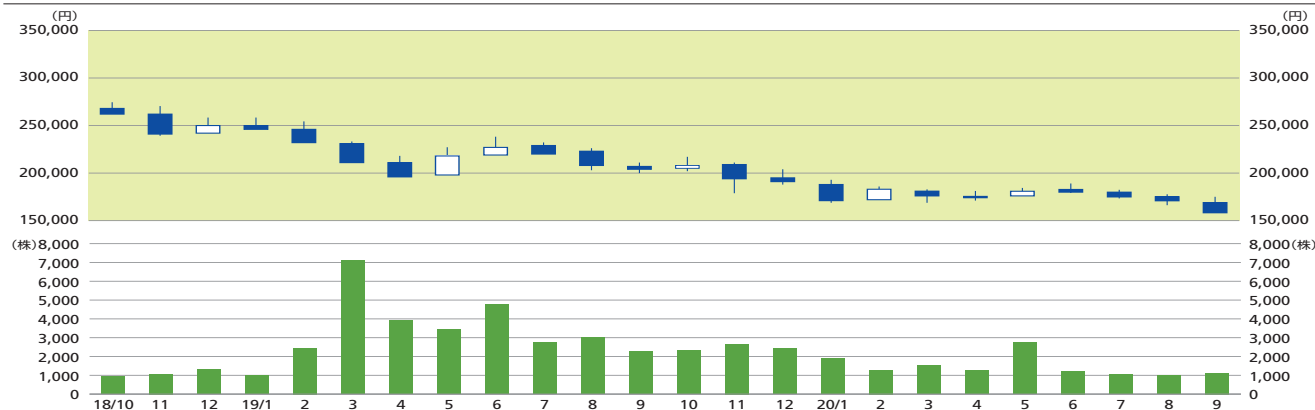
●所有者別株式数



●所有者別株主数



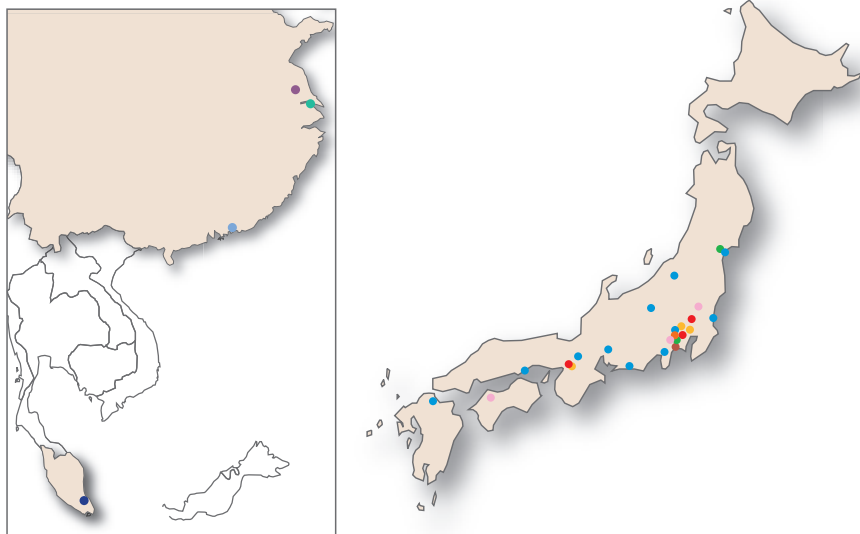
株価と出来高



会社の概要 (平成20年9月30日現在)

会社概要

商号	東京エレクトロン デバイス株式会社 TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立	昭和61年3月3日
資本金	2,495,750,000円
従業員数	830名(連結)
本社	神奈川県横浜市神奈川区金港町1番地4 横浜イーストスクエア



拠点網

- 本社
- 本社営業部 北関東支社 大阪支社
- 仙台営業所 水戸営業所 立川営業所 長岡営業所 松本営業所 三島営業所 浜松営業所 名古屋営業所 京都営業所 岡山営業所 福岡営業所
- 本社営業部厚木サテライト 北関東支社宇都宮サテライト 大阪支社松山出張所
- CN 新宿オフィス CN 府中オフィス CN 大阪オフィス
- 仙台インレビウム開発センター 横浜インレビウム開発センター
- 上海華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロンデバイス上海)
- 香港華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロンデバイス香港)
- 無錫華桑電子科技有限公司(通称:東京エレクトロンデバイス無錫)
- Tokyo Electron Device Singapore Pte. Ltd. (通称:東京エレクトロンデバイスシンガポール)
- パネトロン株式会社

役員等

取締役

代表取締役社長	砂川俊昭
取締役	久我宣之
取締役	天野勝之
取締役	木村勉
取締役	徳重敦之
取締役	東哲郎
取締役	原護
取締役	常松政養

監査役

常勤監査役	矢崎一洋
常勤監査役	遠山憲一
監査役	田中健生
監査役	林田謙一郎

- (注) 1. 常松政養氏は、社外取締役であります。
2. 矢崎一洋氏及び林田謙一郎氏は社外監査役であります。

執行役員

砂川俊昭
久我宣之
天野勝之
木村勉
徳重敦之
穴倉弘明
大崎正之
八幡浩司
武井弘
黒田修治
山田信二
林英樹

個人投資家様向けIR活動

当社は、新聞社や証券会社等が主催するIRフェアや個人投資家説明会に参加しております。

また、当社ホームページ内に個人投資家様向け専用サイトをご用意し、事業内容、業績情報などの配信に努めております。



●個人投資家向け会社説明会
(9月10日・東京証券取引所ビル内)



●当社IRサイト：
<http://www.teldevice.co.jp/ir/>

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
株主名簿管理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
(郵便物送付先) 電話照会先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社証券代行部 証券代行事務センター 0120-78-2031 (フリーダイヤル)
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店
公告の方法	電子公告
上場金融商品取引所	東京証券取引所 市場第二部 (証券コード 2760)

株券電子化がスタートします 平成21年1月 実施予定

平成21年1月に、上場会社の株券の電子化（ペーパーレス）が予定されています。電子化されますとお手元の株券は無効となりますので、株券をお持ちの株主様は必ずご確認ください。

●株券がご本人名義でない場合：株主としての権利を失う可能性がありますので、必ず名義書換を行って下さい。お手続きに関しては、下記当社株主名簿簿管理人までお問合せ下さい。

【中央三井信託銀行】0120-78-2031 (平日9:00~17:00)

●株券がご本人名義の場合：証券会社を通じて「証券保管振替機構（ほふり）」へ預託されることをお勧めします。



電子部品事業にて認証取得

この報告書は再生紙を使用しております。



環境に配慮した「大豆油インキ」を使用しています。